

2022年3月期決算と今期予想 及び 中期経営計画説明会

2022年5月19日



株式会社 メイコー
(証券コード：6787)

■ 業績報告

2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

- **コロナ影響で、8月から9月上旬に武漢・ベトナムで稼働が低下**
- **半導体不足の影響を受け、一部受注調整が出た**
- **原材料コストは高騰したが、販売価格見直しにより対応**

- ウクライナ情勢、中国コロナ政策、半導体不足により、
世界経済は混沌としてきた
- 原材料コストは更に高騰が見込まれる
- 新規事業としてパッケージ基板投資を行う
- 4月に山形天童工場、ベトナムクアンミン工場を着工した

2022年3月期 業績及び今期予想

(単位：億円)

	2021年3月期	2022年3月期	前期比	2023年3月期	前期比
	実績	実績	増減率	予想	増減率
売上高	1,193	1,513	26.8%	1,700	12.4%
営業利益	67 5.6%	133 8.8%	99.1%	155 9.1%	16.9%
経常利益	57 4.8%	143 9.5%	150.9%	145 8.5%	1.4%
当期純利益	46 3.9%	115 7.6%	146.7%	122 7.2%	6.5%
期中平均為替レート (JPY/USD)	105.93	113.06		122.00	
E B I T D A	141	213		237	
有利子負債	674	664		757	
自己資本比率	28.5%	34.7%		37.4%	
D / E レシオ	1.66	1.13		1.09	
R O E	11.4%	19.5%		17.5%	
R O I C	6.0%	10.8%		10.2%	

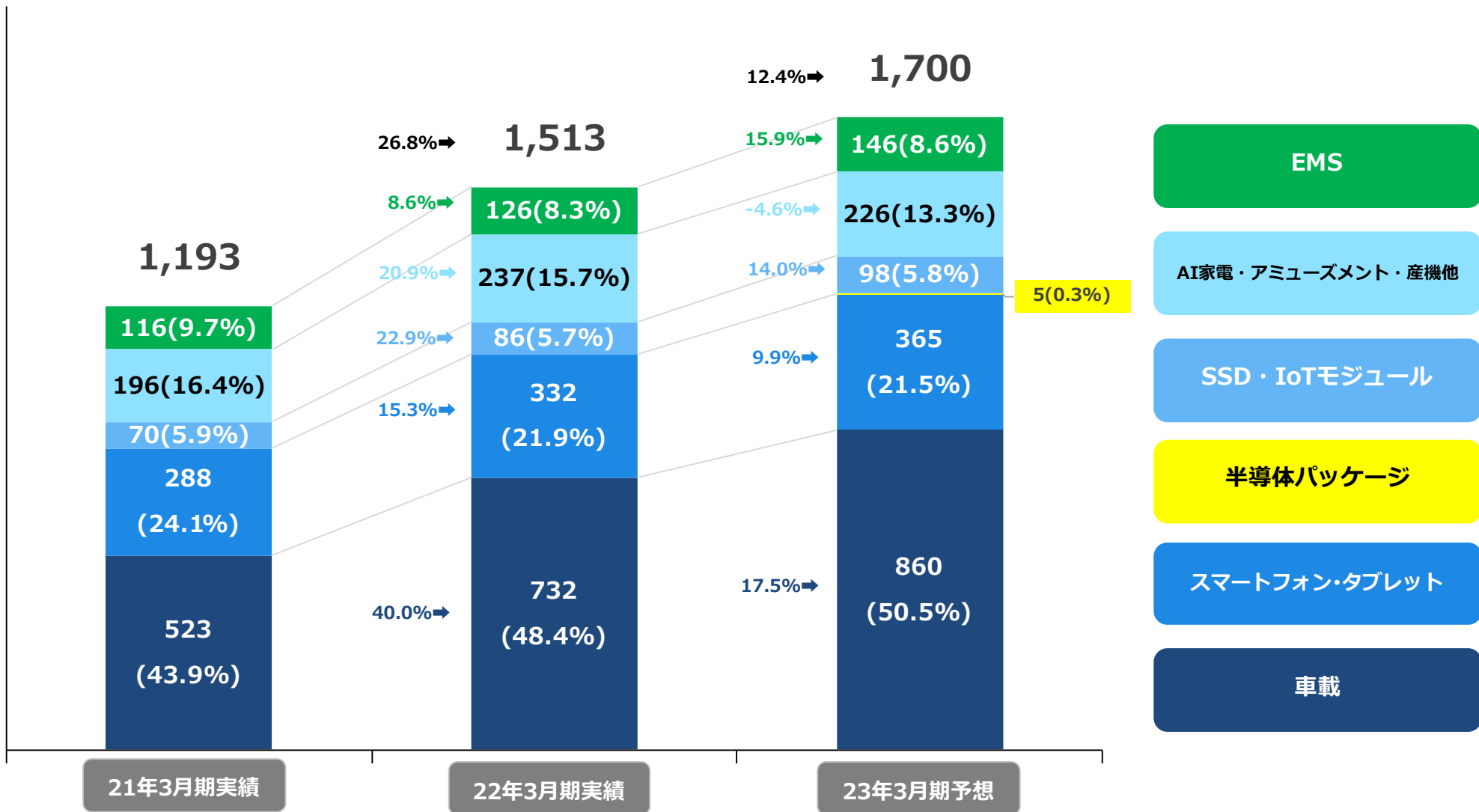
2022年3月期 商品別業績及び今期予想

(単位：億円)

	2021年3月期実績		2022年3月期実績		2023年3月期予想	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	523	36 6.9%	732	63 8.6%	860	75 8.7%
スマートフォン タブレット	288	21 7.3%	332	39 11.7%	365	44 12.1%
半導体パッケージ		-		-	5	-6 -120.0%
SSD IoTモジュール	70	9 12.9%	86	11 12.8%	98	15 15.3%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	196	1 0.5%	237	17 7.2%	226	21 9.3%
EMS	116	0 0.0%	126	3 2.4%	146	6 4.1%
合計	1,193	67 5.6%	1,513	133 8.8%	1,700	155 9.1%

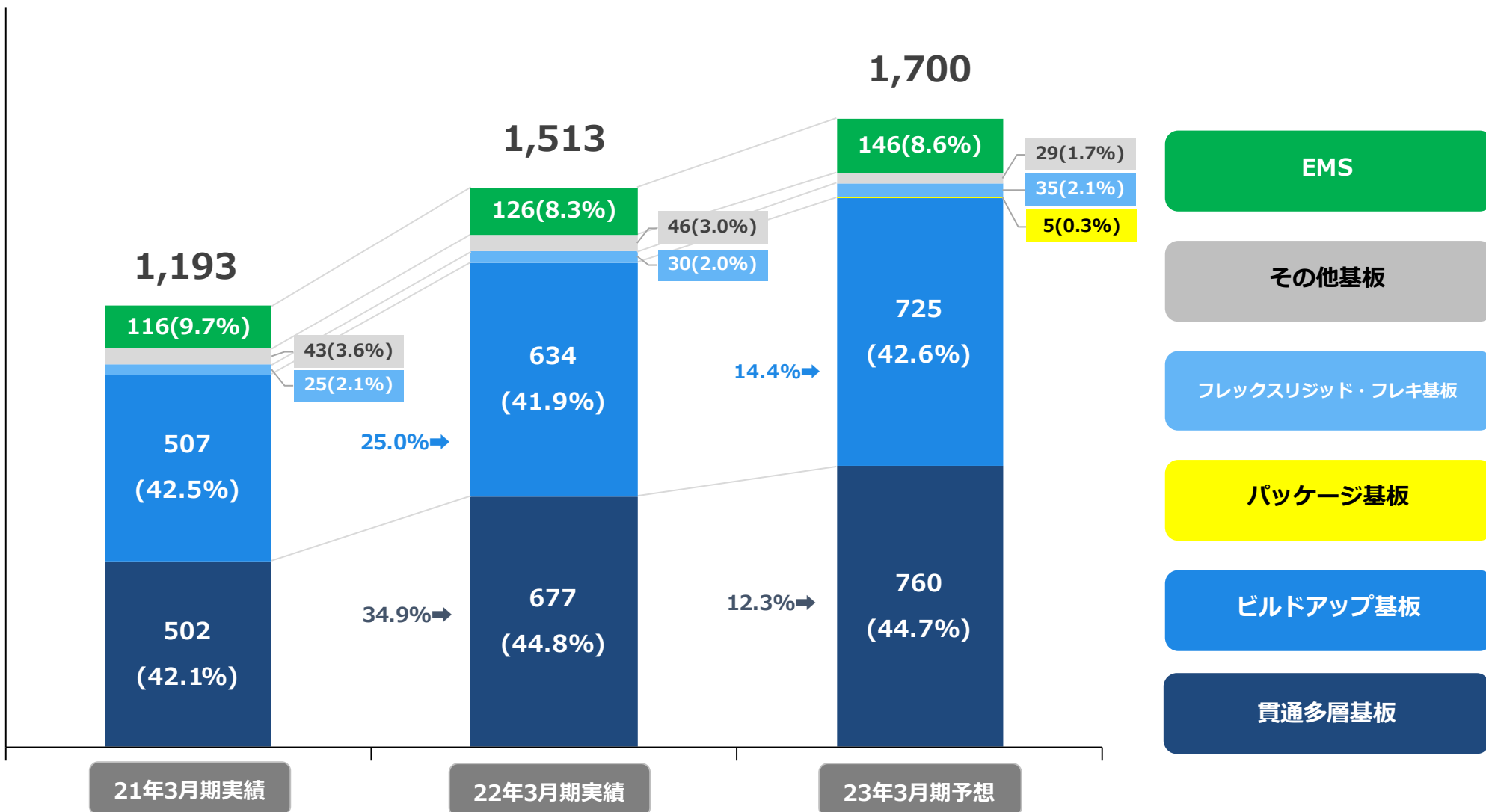
商品別売上推移

(単位：億円)



仕様別売上推移

(単位：億円)



■ 業績報告

2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

中期経営計画

経営理念

モノづくりを通して
お客様に最高の製品とサービスを提供し
社員と社会に幸福を

パーパス (志)

エレクトロニクスの進化に挑戦し貢献する

経営目標

(2027年3月期)

売上高	2,500億円
営業利益	275億円
純利益	218億円
営業利益率	11.0%
為替前提	122円

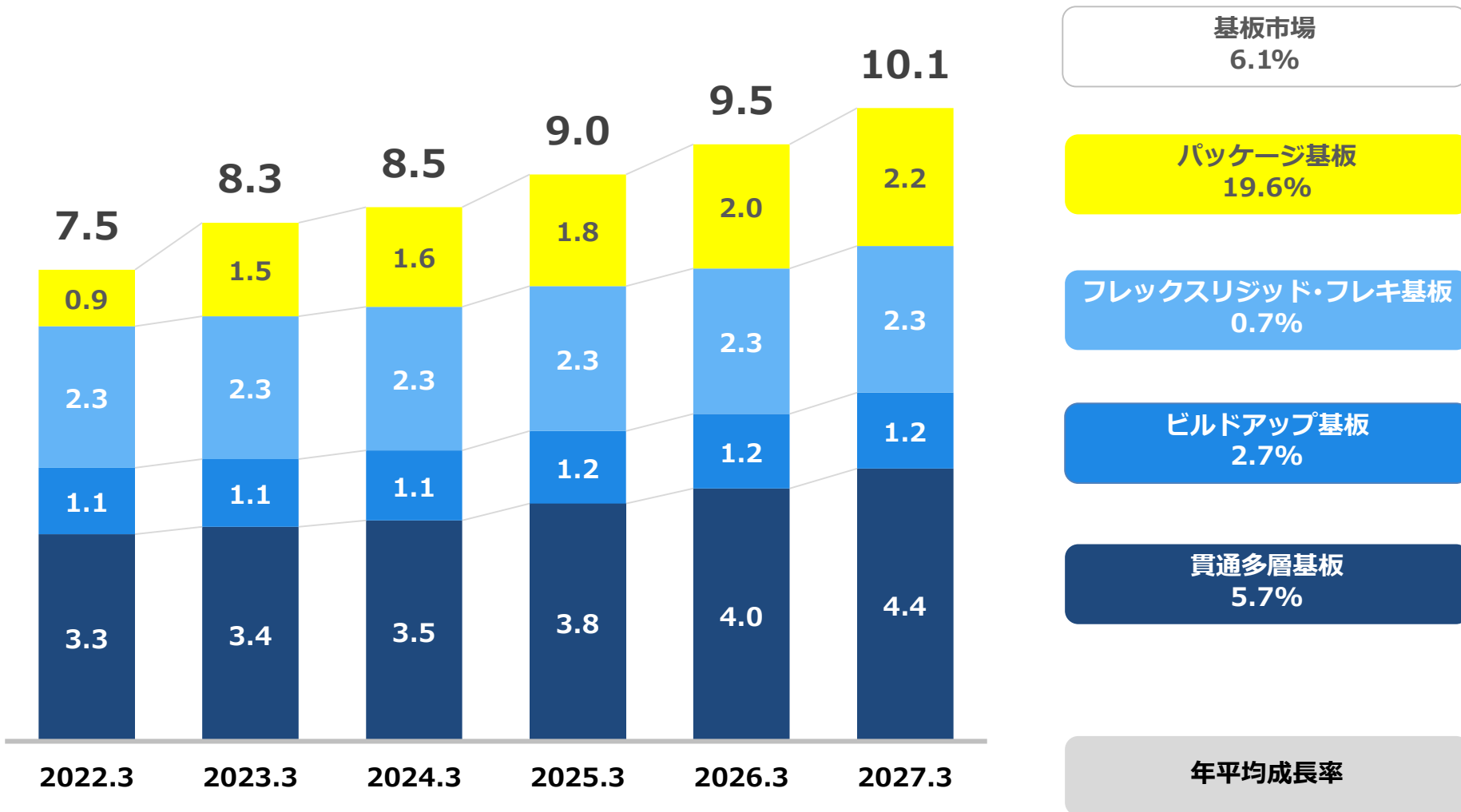
投資

(2022.4~2027.3累計)

設備投資	1,000億円
------	---------

電子回路基板 市場予測

(単位：兆円)



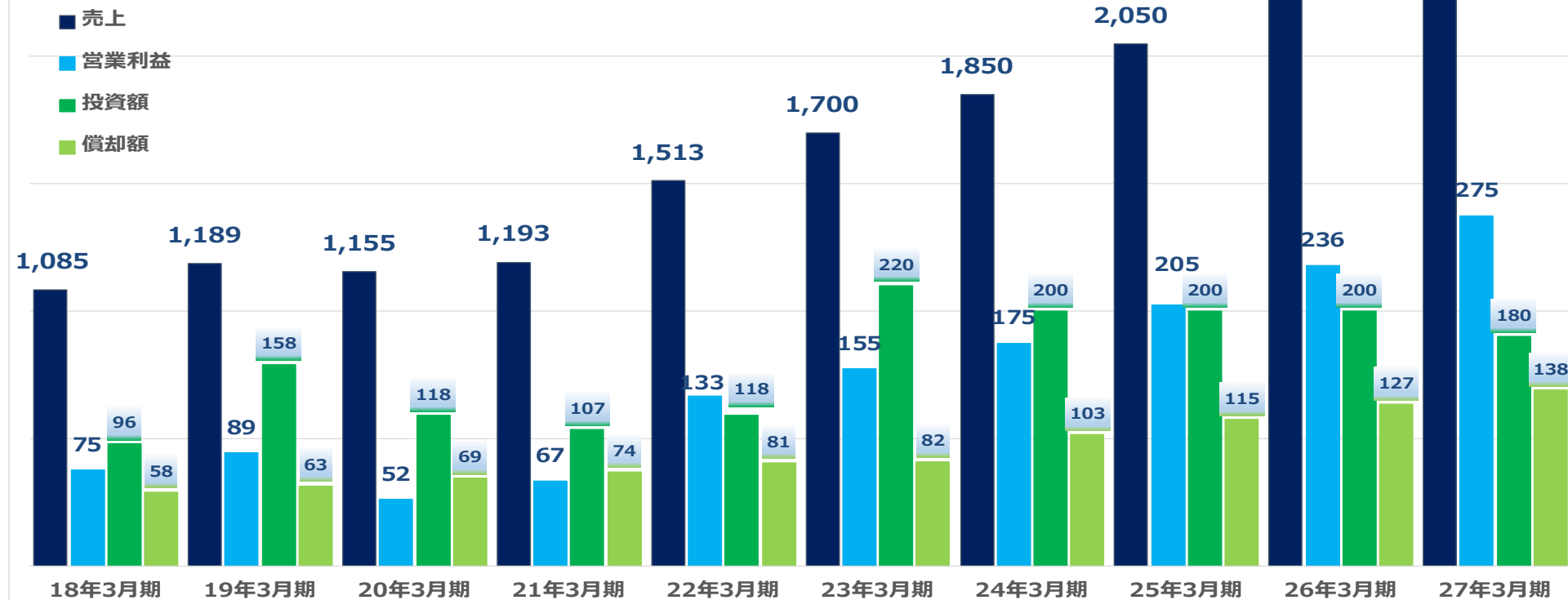
*調査会社のデータに基づき当社が予想

中期業績予想

18.3-22.3 売上年平均成長率 8.7%

22.3-27.3 売上年平均成長率 10.6%

(単位：億円)



EBITDA

133

152

118

141

213

237

277

320

363

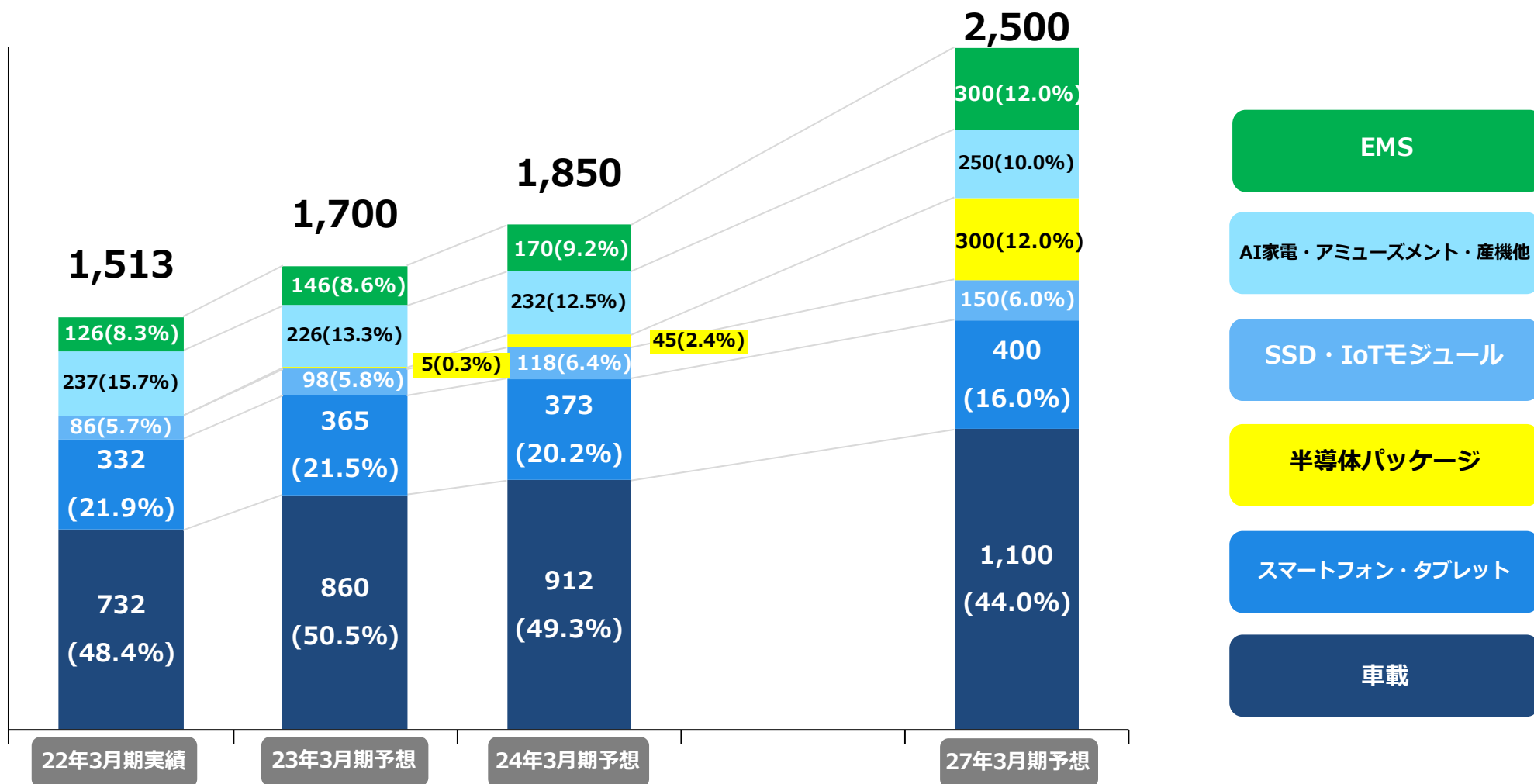
413

平均投資額 120億円

平均投資額 200億円

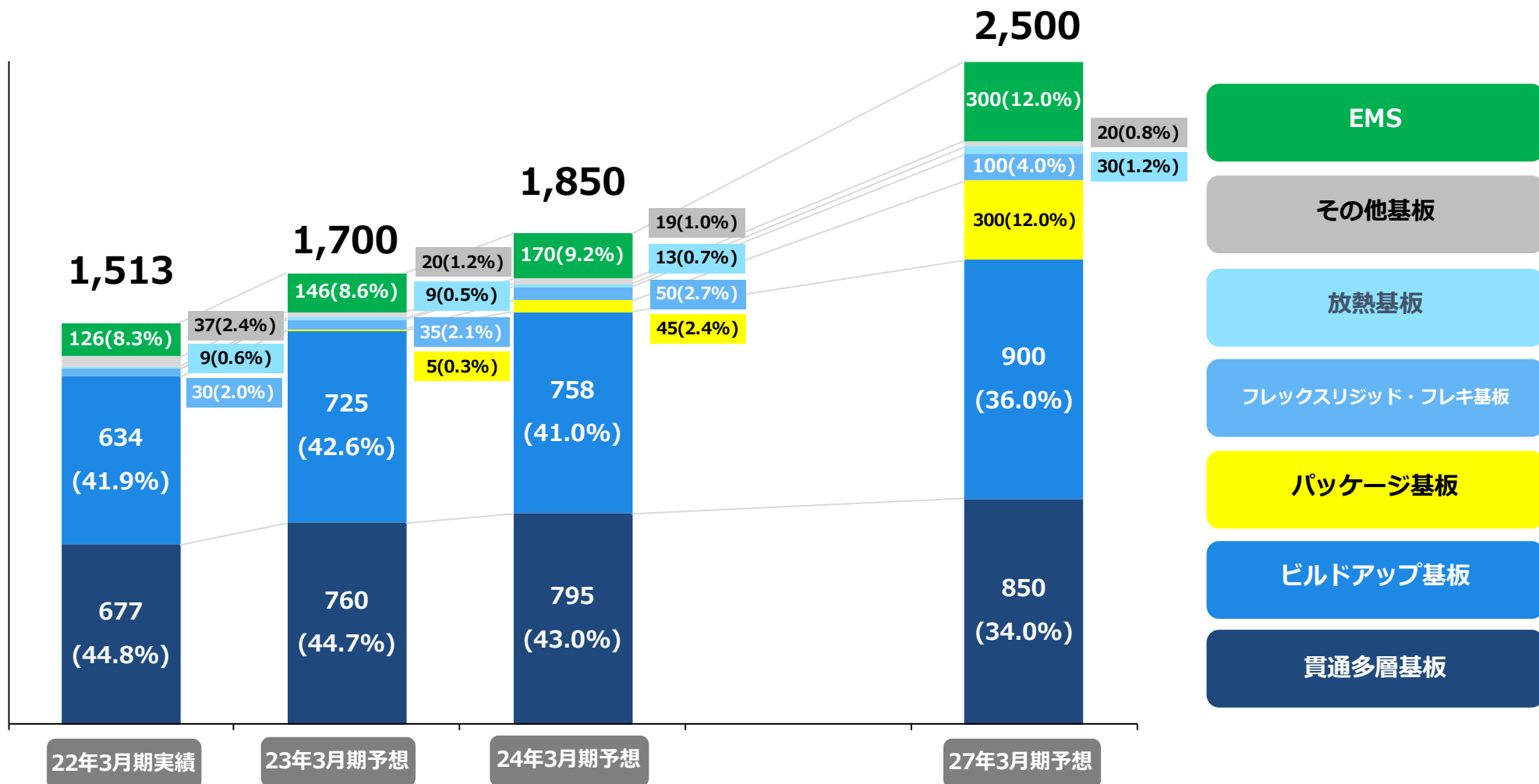
中期経営計画 商品別売上推移

(単位：億円)



中期経営計画 仕様別売上推移

(単位：億円)



■ 業績報告

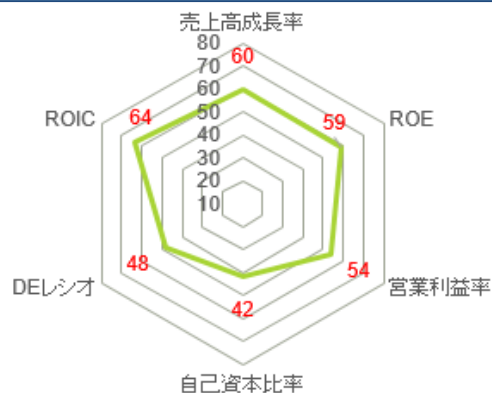
2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

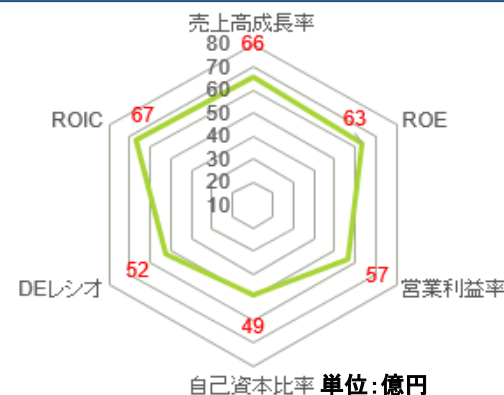
中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

財務戦略と株主還元

1. 設備・研究開発投資を通じ、継続的に売上高・利益を拡大させて行きます。
2. バランスの取れた財務体質の強化を進めて参ります。
3. 連結配当性向は15%を目安とします。
4. 利益を拡大させ、株主価値と配当額の向上に努めます。



1. 利益額の拡大
2. EBITDAの増加
3. 財務バランスの改善



主要基板会社 6社
主要電子部品会社 6社
偏差値換算

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期	対2022年3月期
売上高合計	1,513	1,700	1,850	2,050	2,250	2,500	1.7 倍
営業利益	133	155	175	205	236	275	2.1 倍
営業利益率	8.8%	9.1%	9.4%	10.0%	10.5%	11.0%	2.2 %UP
当期純利益	115	122	141	162	184	218	1.9 倍
減価償却費	81	82	103	115	127	138	
EBITDA	213	237	277	320	363	413	1.9 倍
純資産合計	587	692	816	955	1,112	1,299	2.2 倍
有利子負債残高	664	757	794	747	731	694	44% => 30%
自己資本比率	34.7%	37.4%	40%	44%	47%	50%	15.7 %改善
D/Eレシオ	1.13	1.09	0.97	0.78	0.66	0.53	0.60 改善
ROE	19.5	17.5	17	17	17	17	高水準を維持
ROIC	10.8%	10.2%	10.4%	11.2%	11.5%	12.4%	1.6 %UP

■ 業績報告

2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

ESGの取り組み

E 環境への取り組み（国内事業）

地球温暖化対策	TCFDに基づく対応策実施 ・ 2030年国内CO2排出量原単位50%削減（2013年比） ・ 省エネの推進（原単位：電力▲1.5%/年、燃料▲2.0%/年） ・ 自家発太陽光発電の導入
廃棄物削減	ゼロエミッション推進（2030年リサイクル率80%） 再資源化（銅、パラジウム、金の回収）
水資源の活用	再利用の推進（2030年水使用原単位10%削減）

S 社会への取り組み

従業員エンゲージメント	ダイバーシティの推進（女性活躍推進、海外人財登用推進） 安全で快適な職場づくりの推進（労災ゼロ） 従業員の健康づくりの推進（健康経営優良法人認定取得予定）
地域貢献・地域活性化	自然・環境保護への貢献（リサイクル活動） 地域活性化への貢献（スポーツ振興、地域ニーズに応じた貢献） 社会福祉への貢献

G ガバナンス

経営体制の強化	持続的成長支える経営体制構築
危機管理体制の強化	BCPの強化 山形の第2本社化

■ 業績報告

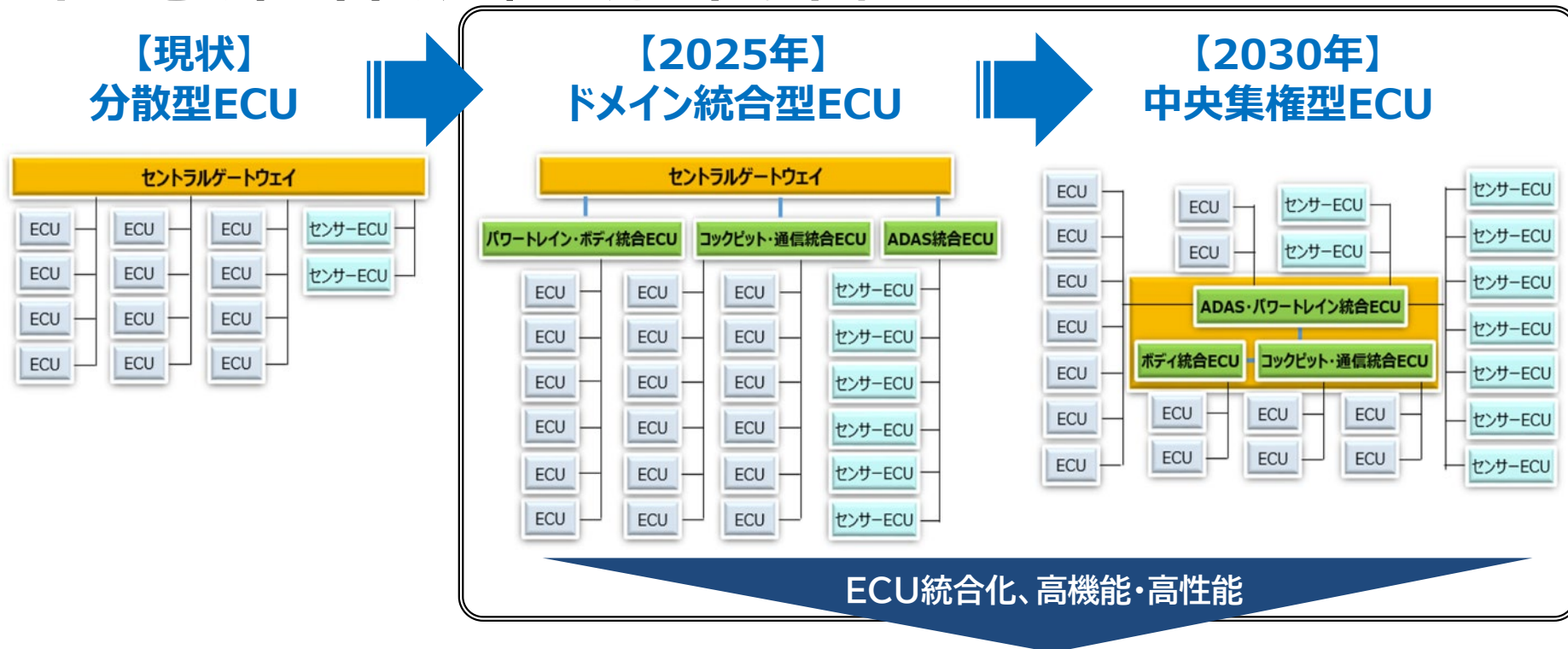
2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

車載用電子回路基板 技術動向

車の電動化・自動運転対応に伴う制御方法



電子回路基板へ求められる技術

高密度・高周波

部品高機能・高性能化⇒狭ピッチ配線
高速信号通信⇒高周波対応

小型化

省スペース化
3D実装対応

放熱

部品発熱⇒
電子回路基板での放熱対応

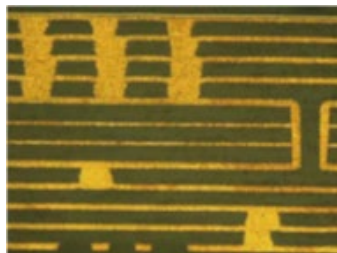
車載用電子回路基板 技術ラインナップ

高密度・高周波

小型化

放熱

ビルドアップ基板 (LVH Stack構造)



- LVH接続による高密度配線
- 高密度配線による配線スペース小
- LowDk/Df基材

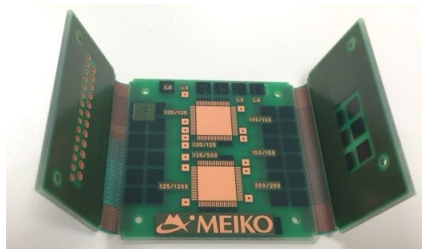
AnyLayer構造



- AnyLayer接続による高密度配線
- AnyLayer接続による配線スペース小
- LowDk/Df基材

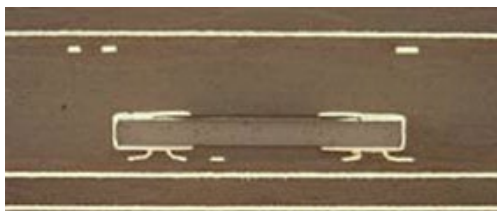
FR-4Flex構造(Semi Flex)

- FR-4.0、4.1を使用した折り曲げ
- 小型・省スペースへの組み込み



部品内蔵構造(Embedded Devices)

- 基板内部へ部品内蔵し配線面積削減
- 発熱部品を放熱側へ内蔵し放熱効率UP



厚銅構造(Heavy Cu)



- 電流配線層厚銅化

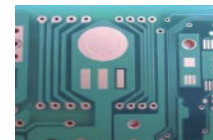
6L貫通 内層105μm

銅インレイ構造(Cu-Inlay)

- 銅インレイを通した部品の放熱

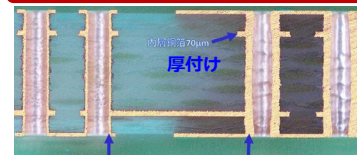


銅インレイ断面写真



銅インレイ部表面写真

MegaTH構造



- 選択THめっき厚付けによる放熱

一般TH MegaTH

メタルベース構造(Metal Base)

- 金属ベース構造での放熱



アルミ



Cu

半導体パッケージ基板 市場動向

Architectural View of 5G-Enabling Technologies

Core Network
(データサーバー)

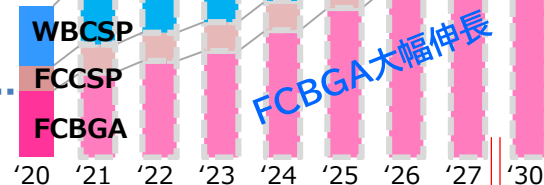
データ量増加



SDN
NFV
Network Slicing

半導体パッケージ基板需要予測

*当社予測



Backhaul Network
(中間回線)

Fiber Backhaul

Wireless Backhaul

Mesh

Fiber Backhaul

高速通信

Radio Access Network

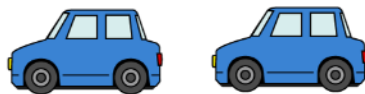
Small Cells
SONs



D2D
(データバックアップ)



V2X
(通信技術)



Low Latency



Fronthaul Network

C-RAN



Fiber Backhaul

Wireless Fronthaul

RRHs



超低遅延
高信頼性

各種端末の
高機能化

半導体パッケージ基板 技術ロードマップ

技術動向

2022年

2025年

2030年

通信データ量増大

5G初期(32Gb)

5G普及(64Gb)

6G初期(128Gb)

高周波化

基板開発内容

メモリ
パッケージ

配線ファイン化 (20/20um~)

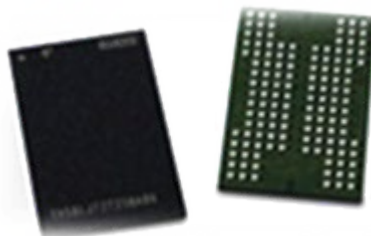
配線ファイン化 (8/8um)

FCBGA
パッケージ

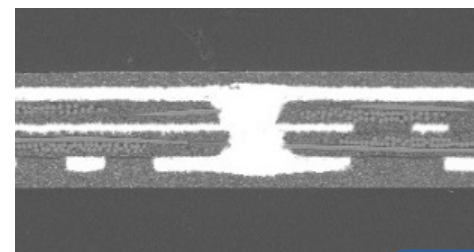
配線ファイン化 (12/12um~)

配線ファイン化 (8/8um)

MSAP工法

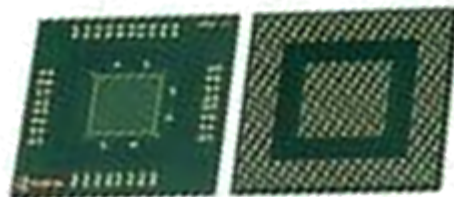
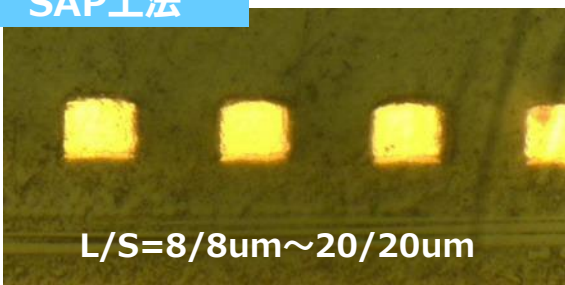


メモリパッケージ

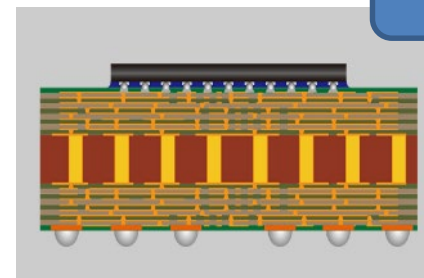


90um程度
薄さの追求

SAP工法



FCBGA



1.0mm程度
細線の追求

基板の量産技術
顧客の実装技術

■ 業績報告

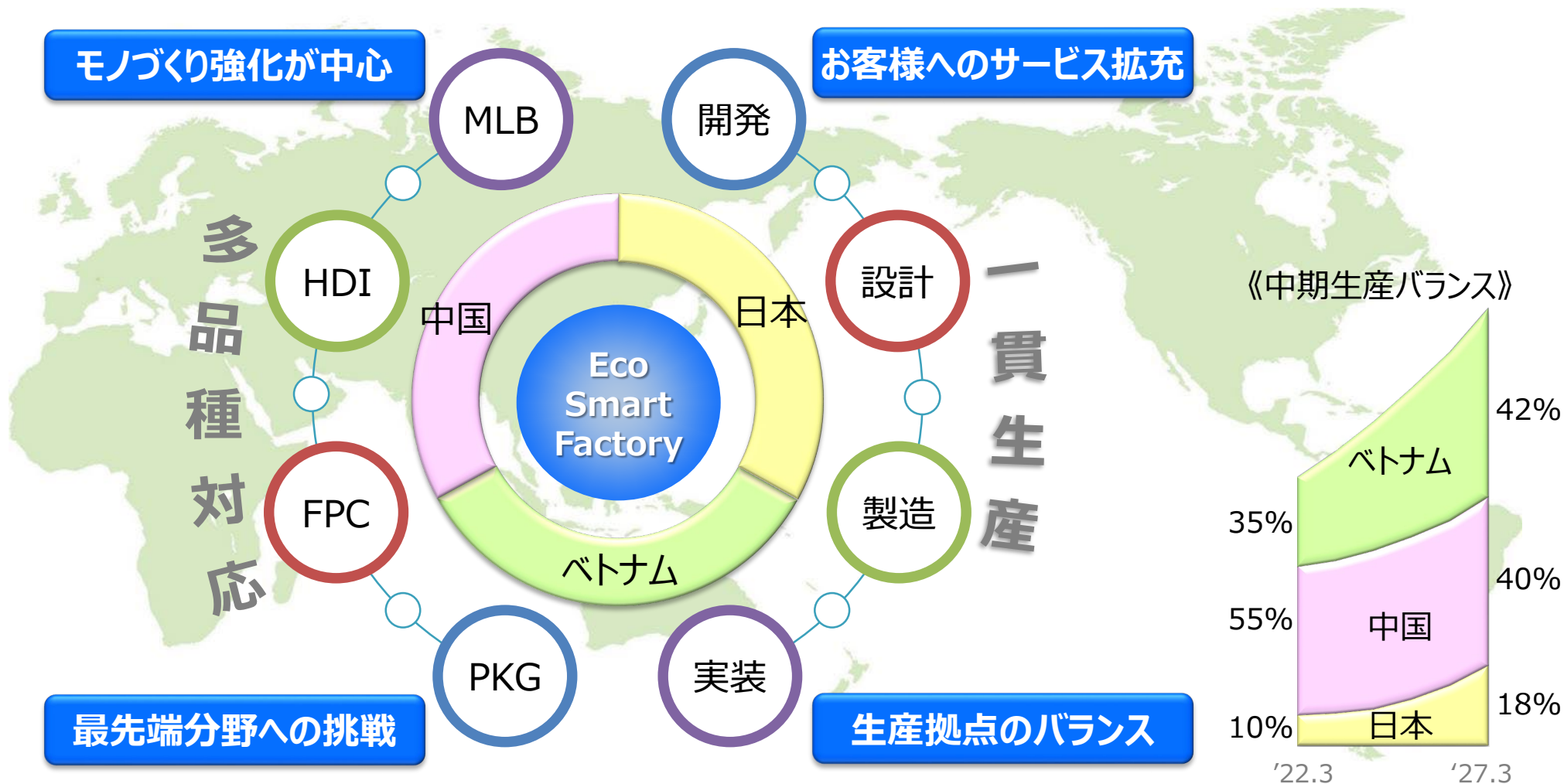
2022年3月期実績
2023年3月期予想

■ 中期経営計画

中期経営計画
財務戦略と株主還元
ESG
中期技術戦略
中期生産戦略

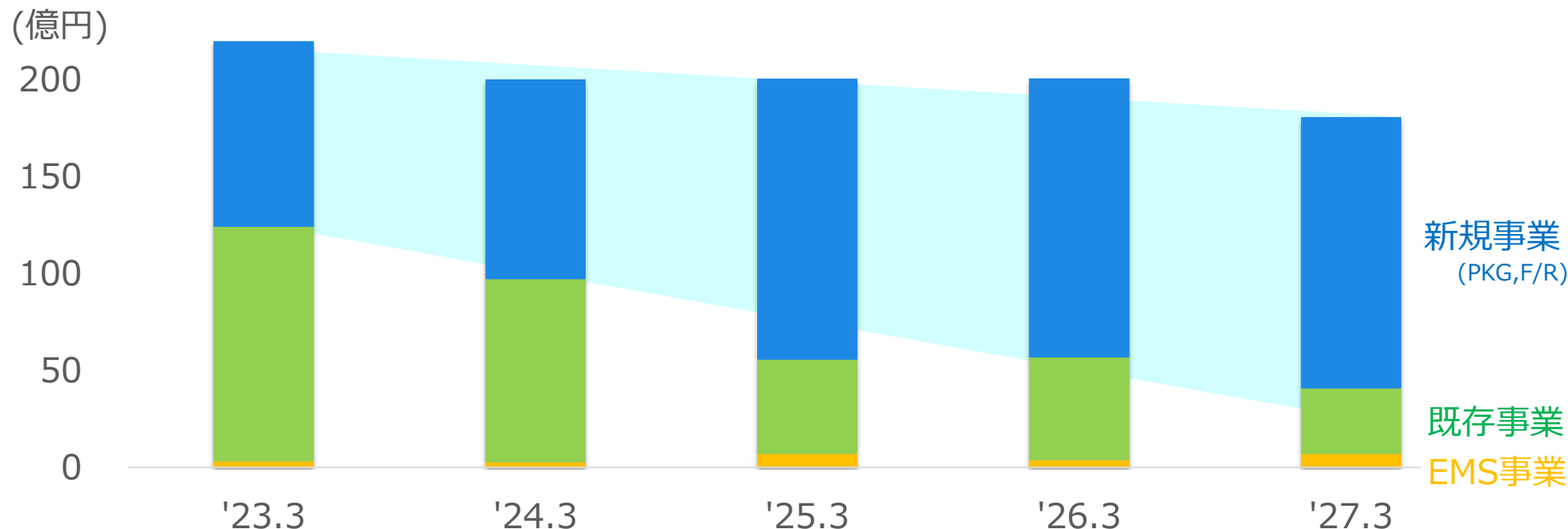
中期生産戦略

長年培ってきた擦り合わせ技術をベースにモノづくり改善強化を更に加速し、常に最先端分野への挑戦と幅広い商品群をそろえ、お客様への安定供給とサービス拡充を図っていきます。



中期投資方針

既存ビジネスについては顧客要求に沿った更なる品質・自動化・環境対応投資を継続しながら、今後の需要拡大が見込める新規ビジネス投資への割合を増やし、持続的な成長を目指す。



《国内投資》



《海外投資》

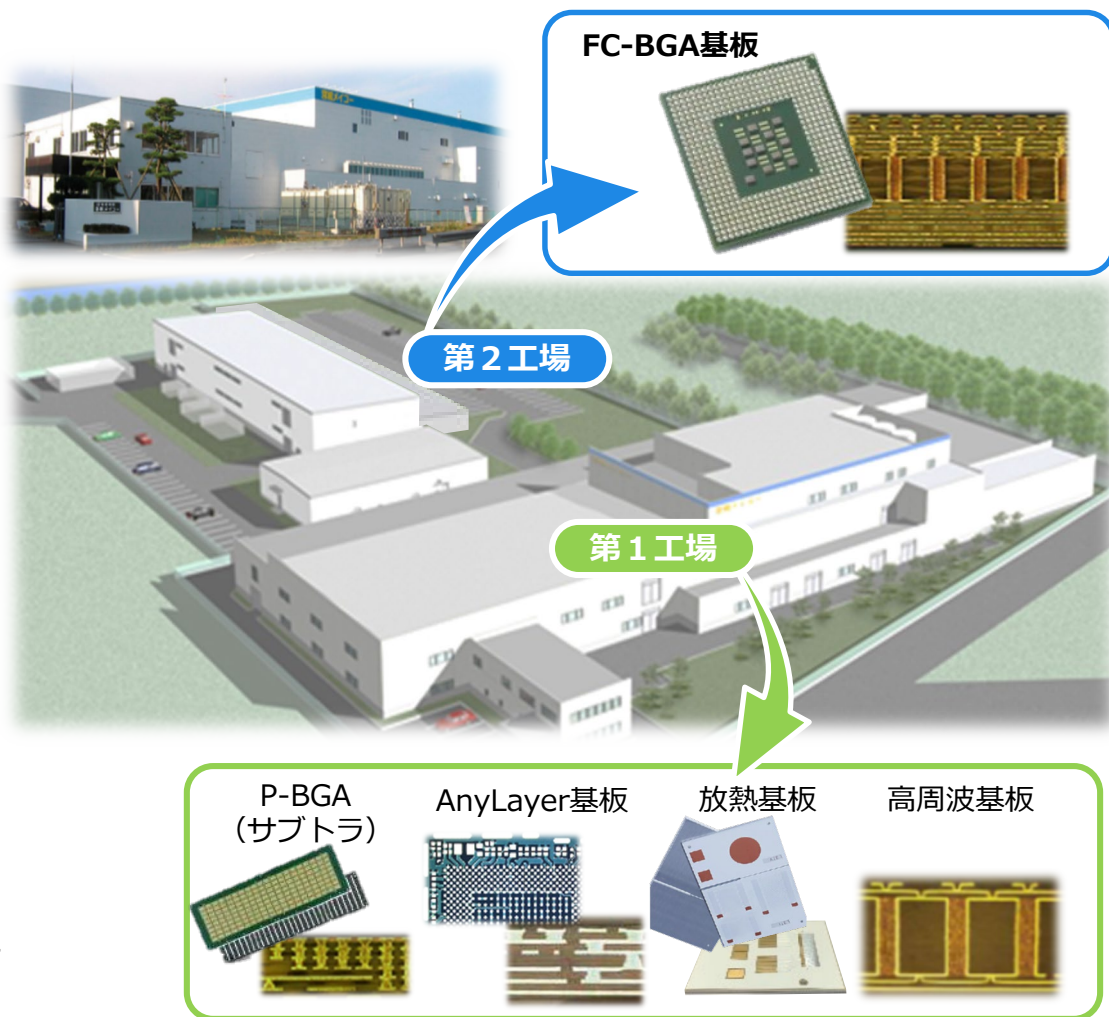


石巻第2工場

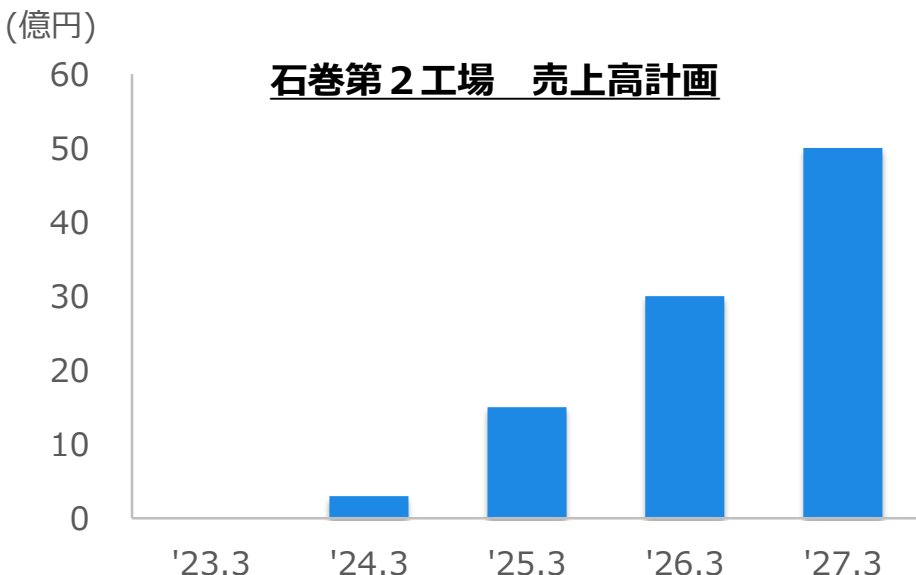
急速なDX化に伴う、ハイエンドFC-BGA市場が全世界でひっ迫する中、石巻第2工場ではレガシー商品の民生及び車載向け需要をターゲットとしたSAP専用工場で小規模小型FC-BGA市場に参入。

石巻第2工場 事業概要

所在地	宮城県石巻市
延床面積	約5,000m ²
投資規模	約70億円
事業内容	半導体パッケージ基板
稼働時期	2023年3月期後半から順次稼働



石巻第2工場 売上高計画



山形事業所 天童工場

車のEV化/ADAS高度化により今後の車載ビルドアップ基板は大幅な増加が見込まれている。その需要に応えるべく山形に国内最大級の最先端エコスマート工場の稼働を目指す。

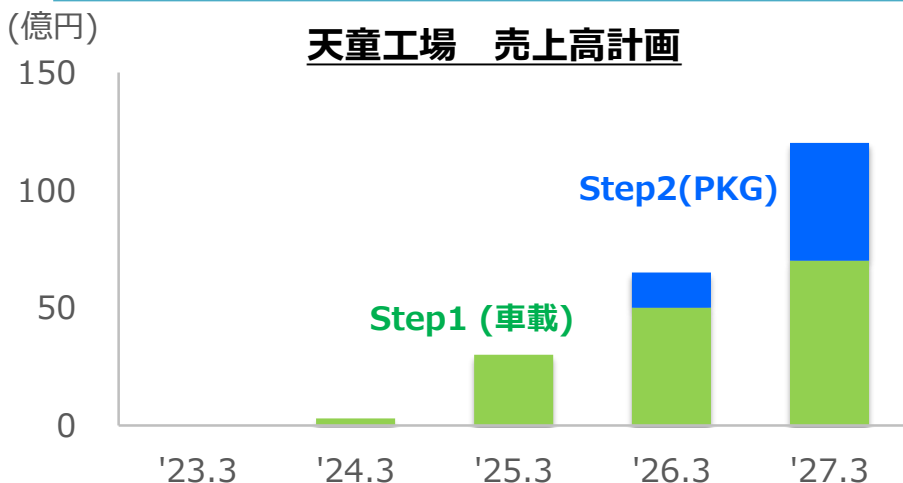
3/30 地鎮祭

山形事業所 天童工場 事業概要

所在地	山形県天童市
敷地面積	約65,000m ²
延床面積	約25,000m ²
投資規模	約150億円 / 約250億円
事業内容	先端車載基板、PKG量産工場 基板技術開発センター機能 国内自動化設備開発・製造



天童工場 売上高計画



ベトナム第3工場

高速通信技術の進化により更なる薄型ハイエンドメモリー基板及び通信モジュール需要が高まり、ベトナム第3工場ではMSAPを活用した薄型パッケージ・モジュール専用ラインを立ち上げる。

ベトナム第3工場 事業概要

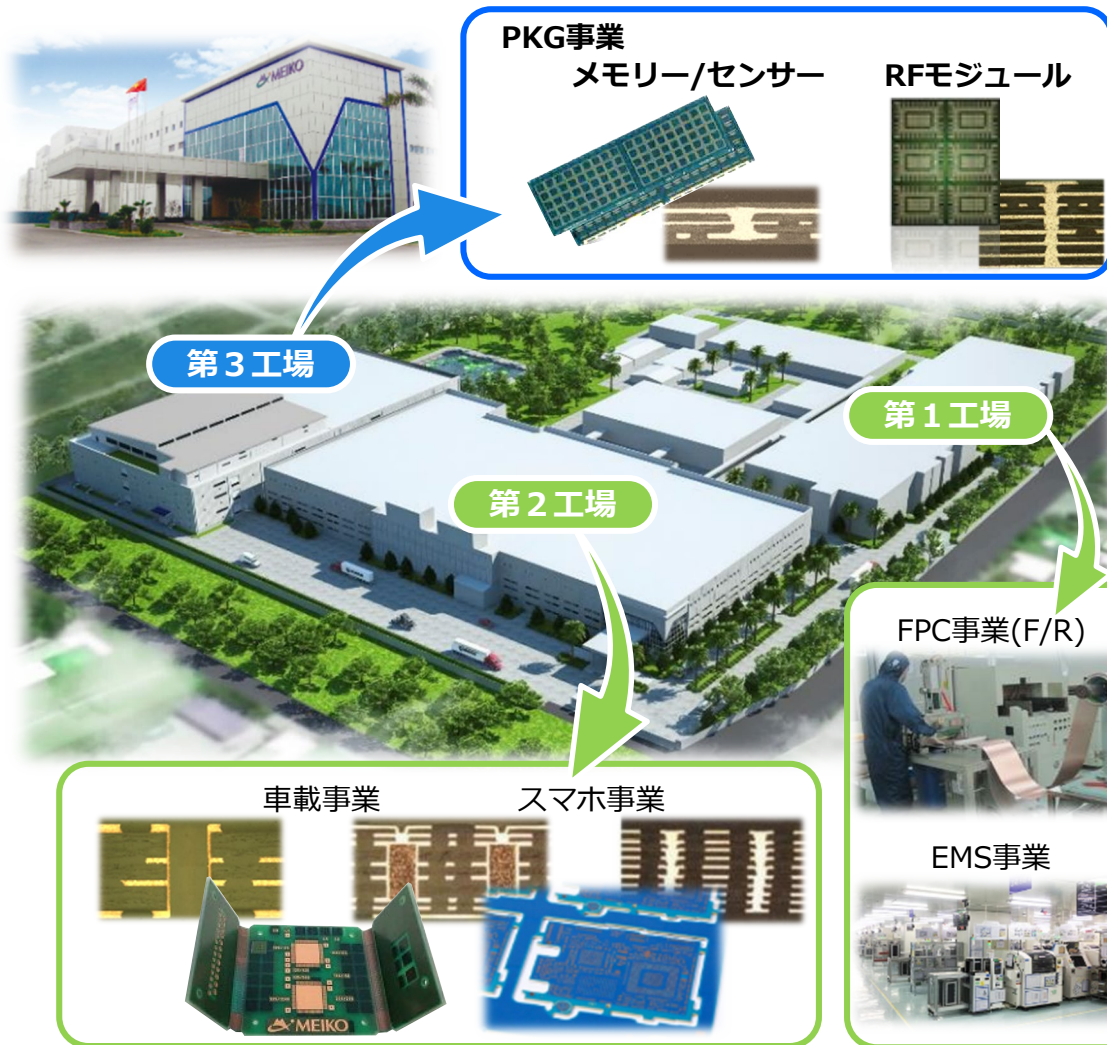
所在地 ハノイ市タックタット工業団地

延床面積 約20,000m² (PKG事業使用面積)

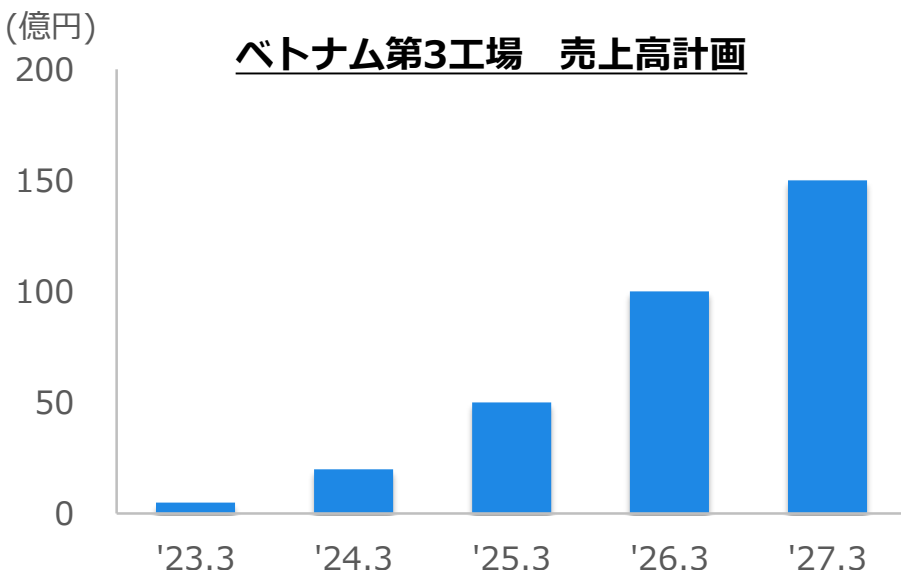
投資規模 約160億円

事業内容 パッケージ・モジュール基板

稼働時期 2023年3月期後半から順次稼働



ベトナム第3工場 売上高計画



クアンミン第2工場

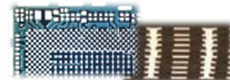
ベトナム第4の拠点として既に貸工場で稼働しているクアンミン第1工場は今後空きスペースでのEMS事業を展開するが、更に第2工場を新設し、今後の新規成長分野をターゲットとする

クアンミン第2工場 事業概要

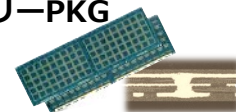
所在地	ハノイ市クアンミン工業団地
敷地面積	約63,000m ²
延床面積	約20,000m ²
投資規模	約100億円
事業内容	パッケージ・モジュール基板 最先端ビルドアップ基板



最先端ビルドアップ



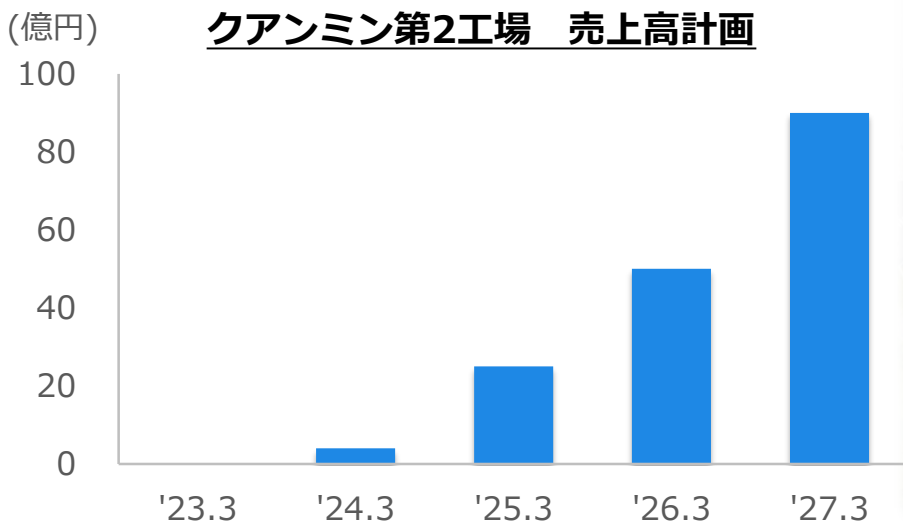
メモリーPKG



4/19 起工式



クアンミン第2工場 売上高計画



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。